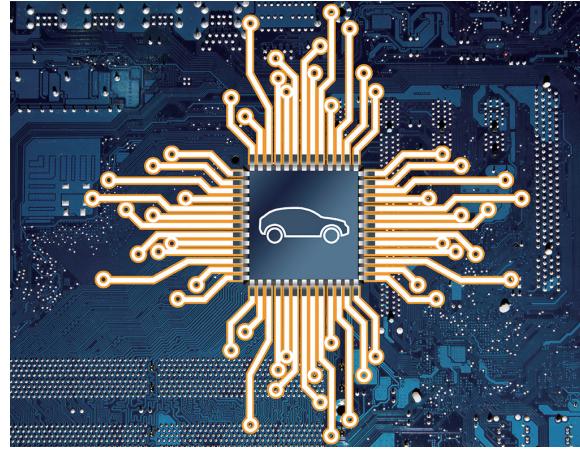


芯片需求超500片 博世供应17片

“从去年开始，芯片供应就出现短缺，但是今年上半年以前，缺芯程度大概也就是20%。也就是说，（零部件）订单有1万片，能给你（车企）8000片，不会造成太大的问题。但从今年7月份开始，量就反过来了。7月份，我们只能满足不到20%的订单需求。8月份也没有好转，9月份稍微得到好转，10月份同样稍微有些好转，但目前来看，满足率仍不超过50%。”在日前举行的2021年度博世智能交通技术创新体验日活动中，博世中国总裁陈玉东这样表示。

占比约达3%

“我们有一个统计数字，一辆汽车最少要用到100多片芯片，最多用到500~600片芯片，从100多到500多片芯片，平均每辆车上有17片博世提供的芯片（2019年的数据）。在这种情况下，博世免不了会用前几大半导体厂商提供的各种各样的芯片，从功率芯片、驱动芯片到MCU（微控制单元）等都有。”陈玉东说。但从去年开始，MCU、ECU（电子控制单元）等多种芯片都开始出现供应短缺现象。



有的车企已经开始“坐不住”，如理想推出“先交付车辆，后补装雷达”的交付方案，其以数百倍高价在黑市求芯片的传闻也开始流传，不过后来被理想辟谣。另外，特斯拉已因芯片短缺开启了涨价模式。

缺芯将成为常态

在汽车行业，芯片短缺现象何时能得到缓解，成为所有人关注的头等大事。但在陈玉东看来，未来汽车业芯片短缺及其导致的零部件缺货将成为常态。

“我在8月份的时候特别焦虑，希望（缺芯导致订单满足率低）这个现象在明年能够有所改观，但百分之百满足大家的需求还是很难的，缺货是常态，只是缺多少的问题。

希望不要再出现今年7~9

月平均满足率只有30%这样的情况。”陈玉东说。

而对于接下来的第四季度和明年，陈玉东认为，“从目前的情况来看，今年第四季度满足率不会达到100%。明年之内，我认为会恢复到今年上半年以前的水平，也就是缺货10%到20%。”陈玉东表示。

不建议主机厂自研芯片

在芯片及包含芯片的零部件供应短缺或将成为常态的情况下，部分车企开始想办法解决问题，并提出了一些可能的方案，其中备受关注的一个方案是，主机厂自己进行芯片及相关零部件的采购、研发和制造。但这种做法是否可行？陈玉东给出了偏否定的答案。

一方面是从成本方面

来考虑。“我们可能是最大的车规级半导体采购商，所以我们的芯片采购量应该是最大的。对这些（芯片）厂商来说，我们是一个比较大的客户，我们的采购成本相比整车厂的采购成本要低。因为对于半导体，量和价是非常相关的。”陈玉东说。

另一方面，陈玉东指出，即便主机厂有意将芯片并类以降低成本，但操作起来也需要较长的时间。“未来唯一可以做的，就是各种各样的控制器，逼得这些人（整车厂）把芯片并类，比如MCU都用一样的MCU，各厂都用这个产品。但未来5年要实现该计划，我个人认为可能性不大。”陈玉东说，实际上，一级供应商、主机厂和半导体厂商在过去20年针对“到底谁采购半导体器件”，一直在博弈。如今，在这种情况下，主机厂试图采购半导体器件，但“5年之内实现还是比较难的”。

为解决当前的芯片短缺问题，博世提出将大力加强国产化芯片的应用。陈玉东同时指出，国产化替代是个漫长的过程，需要两到三年时间，不能寄希望芯片短缺现象马上得到好转。

（摘编自《经济观察报》）

供应链大会求解汽车芯片短缺

在日前举行的2021中国汽车供应链大会上，业内人士指出，应强化车规级芯片与汽车产业链协同，提高芯片国产化率，构建融合网状供应链生态等，打造安全、可控的汽车芯片供应链。

多名业内人士认为，目前国内多家晶圆代工厂均推出扩产计划，产能释放仍需要时间，预计芯片供应紧张的情况或将延续到2022年第二季度，汽车行业芯片短缺现象可能进一步延续至2023年。

为应对芯片供应短缺，政府主管部门正集中力量来解决。

与此同时，在整车厂、芯片企业等共同努力下，汽车芯片国产化替代也加快推进。业内人士认为，国产汽车芯片替代机遇已经到来。

自去年至今，一些中国品牌车企使用了更多国产化替代产品，自主汽车芯片的使用率正不断提升。

多名业内人士还认为，随着汽车产业的重构，应推动汽车供应链从

传统的垂直分层向融合网状转变，整车厂、芯片公司、软件公司等共同打造“圆桌式”的创新生态，满足消费者对智能汽车功能方面及安全方面的需求。还有业内人士建议，未来应加快变革汽车电子电气架构，提高芯片集成度，降低供应链管理的复杂程度。

“好产品都是不断用出来的，车规级芯片需要强化与汽车产业链协同，推动量产应用并不断迭代。为此，要加快打通应用断点、突破协同难点，

逐步加大国产芯片市场占有量。”中国汽车工业协会副秘书长刘宏表示。

“推进汽车电子电气架构由分散式向集中式演进，或是汽车行业‘缺芯’的终极解决方案之一。”地平线总裁陈黎明说，传统的分布式ECU架构中，一辆汽车需要70片至300片MCU芯片，种类繁多，供应链管理难度大；而在未来智能汽车中央计算架构下，高性能MCU芯片仅需10片至20片，供应链管理难度将大幅降低。（罗列）

蔚来成功开发免热处理大型压铸件材料



10月18日，蔚来宣布成功验证开发了可用于制造大型压铸件的免热处理材料。这是中国车企首次将该材料验证并应用于大型结构件上。全新材料将会应用在蔚来第二代平台车型中。蔚来联合合作伙伴开发的全新免热处理材料，避免了传统压铸件在热处理过程中引起的尺寸变形及表面缺陷，让大型车身压铸件成为可能。

免热处理材料的成功面市，将为蔚来推动低碳减排和车身结构设计持续创新打下更加坚实的基础，还可以大幅减少制造过程中的能耗和碳排放。（刘欣）

长春推进汽车产业建设

10月19日，长春汽车产业集群城市推介会举行。吉林省委常委、长春市委书记张志军说，吉林省将以长春市整车为龙头带动，以吉林市为两翼支撑，以辽源、松原、白城等地为原材料基地，打造具有全球竞争力的汽车产业集群。“长春市将全力推动产业链共融，坚持

全省一盘棋，深化与各市州战略合作。”张志军说，吉林省将以长春市整车为龙头带动，以吉林市为两翼支撑，以辽源、松原、白城等地为原材料基地，打造具有全球竞争力的汽车产业集群。（李莉）

罗兰贝格携手天猫共创数字化解决方案

10月15日，罗兰贝格管理咨询公司与天猫签署战略合作备忘录，将与阿里汽车事业部、天猫消费者和生态策略中心携手，在今年“双11”期间启动汽车新零售数字化解决方案的深度合作，并在未来共同探索汽车数字化营

销、消费者运营、产业链升级改造等领域的创新，推进汽车行业数字化升级。罗兰贝格全球高级合伙人郑赟、阿里汽车事业部总经理何春雷，以及天猫消费者和生态策略中心总经理刘洋等嘉宾出席了本次活动。（晓雯）

